

**CROSS TEARING LAMINATED FILM**

Publication number: JP63132051

Publication date: 1988-06-04

Inventor(s): WATANABE TAKEHIKO; MIYAZAKI KATSUNORI;  
OHASHI KAZUYOSHI

Applicant(s): TOYO BOSEKI KK

Requested Patent:

Applicant Number: JP19860279044 19861122

Priority Number(s): JP19860279044 19861122

IPC Classification: B32B27/32; B29C55/08; B32B15/08;  
B29L9/00

**Abstract**

OBJECT: The present invention has its object for providing a cross tearing laminated film having a good tearing property and directional character of tearing, and low heat-sealing property.

CONSTITUTION: A cross tearing laminated film, which essentially consists of a heat-sealable film layer (A layer) comprising a polymer and substantially cross uniaxial-stretched, and a base film layer (B layer) comprising a polypropylene polymer having melting point higher than the polymer of A layer and substantially cross uniaxial-stretched.

⑩ 日本国特許庁(JP) ⑪ 特許出願公開  
⑫ 公開特許公報(A) 昭63-132051

⑬ Int.Cl.<sup>4</sup> 識別記号 庁内整理番号 ⑭ 公開 昭和63年(1988)6月4日  
B 32 B 27/32 8115-4F  
B 29 C 55/08 7446-4F  
// B 32 B 18/08 2121-4F  
B 29 L 9:00 4F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

⑯ 発明の名称 横方向引裂性積層フィルム

⑰ 特 願 昭61-279044

⑱ 出 願 昭61(1986)11月22日

⑲ 発 明 者 渡 辺 武 彦 京都府京都市西京区大枝西新林町3丁目1-110  
⑲ 発 明 者 富 崎 勝 憲 愛知県犬山市大字木津字前畑344  
⑲ 発 明 者 大 橋 一 善 大阪府吹田市泉町4丁目31-2  
⑲ 出 願 人 東洋紡績株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号

明 細 書

1. 発明の名称

横方向引裂性積層フィルム

2. 特許請求の範囲

(1) 実質的に横一軸延伸されたポリマーからなるヒートシール性フィルム層(A層)と、積層層を構成するポリマーよりも高融点のポリプロピレン系重合体からなる実質的に横一軸延伸されたベースフィルム層(B層)を逐層形成とする横方向引裂性積層フィルム。

(2) A層とB層が横方向に2〜15倍延伸されている特許請求の範囲第(1)項記載の横方向引裂性積層フィルム。

(3) A層が融点80〜145℃の熱可塑性樹脂で、厚さ0.3〜20μであることの特許請求の範囲第(1)項もしくは第(2)項記載の横方向引裂性積層フィルム。

(4) B層の片面にA層、他面に他の延伸フィルム、アルミニウム箔もしくは紙が接着剤を介して

被覆されている特許請求の範囲第(1)項、第(2)項、もしくは第(3)項記載の横方向引裂性積層フィルム。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、横方向の引裂性及び引裂きの方向性に従い、かつ低融点ヒートシール性が優れたポリプロピレン系積層フィルムに関するものであり、食品や医薬品等の自動包装用に好適で、密封が容易な包装材料を経済的に提供するものである。

(従来の技術)

近年、商品をフィルムで包装する場合、自動包装機による包装が多くなり、従前はヒートシールにより行われている。更に自動包装機の高速化、高効率化に伴い、包装材料の一面の低融点ヒートシール性や膜の厚さ等が要求されるようになった。

一方、包装された商品は使用時に開封する必要があり、一般には手で引裂くことが多く、横方向の引裂の要求が高まっている。

## 特開昭63-132051(2)

結果、ヒートシール性を与えるために低密度のポリエチレン、ポリプロピレン等の熱延伸フィルムをポリプロピレンやポリエチレンの二軸延伸フィルムにラミネートした複合フィルム等が用いられている。しかし、ヒートシール層として熱延伸フィルムをラミネートした場合は、引裂強度が高過ぎて開封が困難となる。

また、ヒートシール性二軸延伸ポリプロピレン複層フィルムを用いることもあるが、このフィルムは開封用切口から方向性をもって引裂くのが困難であり、液体や粉体を包装した場合、切口が溶全体に及んで内容物が漏れたり、クッキー等のこねれやすい菓子等を包装した場合、切口が斜め切れして、取出し口が小さくなり、内容物を取り出すのが困難になる等の欠点がある。

更に開封を容易にするために、ヒートシール部に開封用切口を設けている場合が多いが、方向性をもって引裂くのが困難なことが多い。引裂性を向上させるために結晶性低分子量ポリオレフィンを取り入れる方法(特開昭58-18280号等)

が知られているが、この方法では任意方向に手切れ性があるために、同時に方向性をもって引裂くことができない。

また引裂きの方向性を持ったヒートシール性ポリプロピレン系フィルムとして一軸延伸ポリプロピレンフィルムをヒートシール層として他の高強度フィルム等とラミネートする方法(特公昭61-40581号)があるが、低屈ヒートシール性に乏しく、高速度封包機械に使用するためには困難が伴う。更に一軸延伸ポリプロピレンフィルムを用いる方法(特開昭58-78844号等)も知られているが、膜が厚く、単体フィルムでは耐熱性に乏しく、高速度封包機械に使用するためには不十分であり、かつ封端が脆軟なために、引裂き方向を逸した時には、充分な引裂き性が得られない等の欠点がある。

(発明の解決しようとする問題点)

本発明は、上述したような従来のフィルムの欠点を改良するものであって、良好な引裂性及び引裂きの方向性を有し、かつ低屈ヒートシール性が

優れた複層フィルムを従来の引裂強度より少なくすることや、複層フィルムの厚みを薄くすることができるとなどにより経済的に提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

上述目的を達成するために、本発明は実質的に一軸延伸された複合体からなるヒートシール性フィルム層(Ａ層)と、該Ａ層を構成する複合体よりも高強度のポリプロピレン系複合体からなる実質的に一軸延伸されたベースフィルム層(Ｂ層)を基本構成とする複層フィルムを提供する。

本発明において、ベースフィルム層(Ｂ層)を構成するポリプロピレン系複合体は、融点が140℃以上、好ましくは融点150℃以上のプロピレンを主体とした複合体であって、例えばアイソタクタ性指数85(重量)％以上のアイソタクタ性ポリプロピレン、エチレン含有量が7(重量)％以下のエチレン／プロピレン共重合体、プロピレンが90(重量)％以上のプロピレンと炭素数が4～5のα-オレフィンとの共重合体があ

り、これらの重合体の重合物も使用される。

該ポリプロピレン系複合体は固有粘度(1)35でテトラリン溶液)が1.0～3.0dl/gであるのが好ましく、特に1.5～2.5dl/gであるのが好ましい。固有粘度が1.0dl/g未満では透明な包漬材料が得られにくく、逆に3.0dl/gを超えると、押出性が低下し、外観が悪く、光沢の悪い、商品価値が低下するような包漬材料になる。

本発明においてベースフィルムには、ポリプロピレン系複合体の機械的もしくは熱的性質を低下させない程度に低分子量可塑性樹脂等の他の複合体、帯電防止剤、滑剤、ブロッカング防止剤等を含有させて可塑性を向上させることができる。低分子量可塑性樹脂としては天然もしくは合成ワックス、炭化水素樹脂、ポリシロキサン、フェノール樹脂、増粘化樹脂炭化水素ワックス、塩素化多環芳香族炭化水素等がある。

本発明においては、上記ベースフィルム層の少なくとも片面上にヒートシール性フィルム層が設けられている。ヒートシール性樹脂は、融点が

## 特開昭63-132051(8)

80～145℃の熱可塑性樹脂であり、融点が100～140℃のものが一層好ましい。融点が80℃以下の樹脂は耐熱性に乏しく、145℃以上ではヒートシール強度を高くする必要があり、共に高強度耐熱性に達していない。

ヒートシール性樹脂としては好ましいものには、上記樹脂の融点を持つオレフィンのホモポリマーもしくはコポリマー、例えば低密度ポリエチレン、ポリブテン-1、エチレン-プロピレンコポリマー、プロピレンと炭素数が4～10のα-オレフィンとのコポリマー、エチレンと炭素数が4～10のα-オレフィンとのコポリマー、エチレンとプロピレンと炭素数が4～10のα-オレフィンとの三元コポリマー、ブテンとブテン以外のα-オレフィンとのコポリマーがあり、そのほかアイオノマー、エチレン酢酸ビニルコポリマー、エチレン-アクリル酸コポリマー等の単独もしくは混合樹脂が例示される。

上記ポリマーのうち、特にプロピレン-ブテンランダムコポリマー、エチレン-ブテンランダム

コポリマー、エチレン-プロピレン-ブテンランダムコポリマー、エチレン-プロピレンランダムコポリマー、直鎖状低密度ポリエチレン、アイオノマーが好適である。

また、本発明の樹脂フィルムにおいては、ベースフィルムの片面にヒートシール性フィルム層を設け、他面に金属、ポリ塩化ビニリデン、ポリエチレン等と接着性の良好な接着性樹脂層を設けてもよい。

本発明の樹脂フィルムの製造法としては、ベースフィルム層、ヒートシール層を別個の押出機から押出し、押出状態で重合液を作り、成形する共押出法、未延伸フィルム又はシートに他方のフィルムを溶融押出しして接着する方法等がある。また、ポリエチレン系の樹脂を樹脂するには、両層の接着性を向上させるために、両層の間に、無水マレイン酸、低密度ポリエチレン等の接着性樹脂を積層してもよい。

上記樹脂系延伸フィルム又はシートは、横方向に2～15倍、好ましくは、4～10倍に延伸さ

れる。延伸倍率が3倍以下の場合には充分な分子配向が得られず、延伸方向に機械的に引裂けやすい欠点がある。また15倍以上延伸することは困難を伴い、かつ低密度ヒートシール性が悪化する。延伸方法は特に限定されないが、80～185℃、特に100～150℃でテンター延伸法により延伸するのが好ましい。

なお、横方向には機械的に延伸しないが、引裂きの方向性が決められない程度に3倍以下に延伸することを目指すものではない。

延伸した樹脂フィルムは、熱安定性を高めるために、100～185℃で1～60秒間熱処理するのが望ましい。またフィルム表面には、必要に応じてコロナ処理などの表面処理を施してもよい。

本発明の樹脂フィルムの層の厚みは、用途に応じて適宜調整するが、通常5～100μmの範囲であり、汎用されるのは15～80μmである。またヒートシール層の厚みは0.0～20μm、特に0.5～15μmが好ましく、樹脂フィルム全体の

厚みの0.2～50%の範囲である。ヒートシール層の厚みが0.5μmよりも厚いと、充分なヒートシール性が得られず、また20μmよりも厚いか、全体の厚みの50%よりも厚いと樹脂フィルムの強が弱くなり、自動包装適性が低下したり、引裂性が悪くなる。

本発明の樹脂フィルムは、単独でヒートシール層同士を接合させてヒートシールしたり、他のフィルム、アルミニウム箔、紙等とラミネートした複合フィルムとして、ヒートシール層同士を接合させてヒートシールして、引裂性及び引裂きの方向性の優れたしかも膜があり、用途に適合した特性、例えばガスバリア性、印刷性、耐熱性等を持つ包装フィルムとすることが出来る。

本発明の樹脂フィルムを樹脂の例について説明すると、第1図はポリプロピレン系ポリマーからなるベースフィルム(1)の片面にヒートシール性フィルム(2)を積層した樹脂フィルムの側面図であり、第2図は、ポリプロピレン系ポリマーからなるベースフィルム(1)の両面にヒートシール性フ

## 特開昭63-132051(4)

フィルムを形成した被覆フィルムを示す。第1図及び第2図は本発明の基本的被覆フィルムの構成である。また第3図は第1図に示された被覆フィルムの片面に接着剤を介して延伸フィルムもしくは紙を積層した例であり、8は接着剤層、4は延伸フィルム又は紙の層である。第4図は、第1図の被覆フィルムの片面にアルミニウム箔及び延伸フィルムもしくは紙を接着剤層8によって順次積層した例を示す。

次に実施例について本発明を更に説明する。なお、実施例中の各データの測定値は次のように行った。

① ヘーズ：JIS-K-6714法に據り、東洋精機社製「ヘーズメータ」を用いて測定した。

② ヤング率：ASTM-D-882法に據り、測定した。

③ 引張の方向性：被覆フィルムの端面から縦方向に開封用切口を5mm入れ、引張きの力方向角度を縦方向に対して60°以内の角度で角度を変えて引張り、その具合で次の通り評価した。

○：順向きに包膜された。

△：フィルムの延伸、ヒーターへの付着等で時々包膜不能になった。

×：ヒーターへの付着、ヒートシール強度不足等で、ほとんど包膜不能。

## 実施例 1

ベース樹脂層として、固有粘度2.0dl/g、アイソタクチックポリプロピレン100重量部に對してアルキルアミノエチレンオキサイド付加物0.8重量部、シリカ0.1重量部を混合したものを用い、またヒートシール性樹脂層として、プロピレン含有率81重量%のプロピレン・エチレンコポリマー50重量部とポリブテン1、50重量部との混合物に對し、エチレンアミド0.3重量部とシリカ0.8重量部とを混合したものを用いた。

上記各樹脂を2台の押出機で共押出しし、ベース厚178μ、ヒートシール厚25μの2層被覆フィルムを得た。次いで120℃で横方向に3倍延伸し、5%の緩和率を与えながら140℃で

○：引張きの力方向を変えても、縦方向にはほぼ一直線に引張けた。

△：引張きの力方向が横方向から外れると、一直線に引張けなかった。

×：縦方向に方向性をもって引張けなかった。

④ ユレンドルフ引張強度：JIS-P-8118法に據り測定した。

⑤ ヒートシール強度：東洋精機社製材料ヒートシーラーにより、圧力1kg/cm<sup>2</sup>、1秒間の条件でヒートシールした後、200mm/分の速度で剥離した際の初離強度を測定した。

⑥ 手切れ性：指先で被覆フィルムを引張いた時の引張きの延長度によって次の通り評価した。

○：簡単に引張けた。

△：爪を立て、力を入れれば引張けた。

×：引張けなかった。

⑦ 自動包膜適性：富士機械製作所製 横型ロー包膜機を用い180℃、120mm/分の条件で包膜材料を自動供給して行い、その適性を次の通り評価した。

5秒間熱処理した。

得られた被覆フィルムは全厚みが25μであり、第1図に示すような物性を有し、引張性、引張きの方向性、低層ヒートシール性が優れ、自動包膜適性も良好であった。

## 比較例 1

融点138℃のエチレン・プロピレン・ブテン-1三元コポリマー（共重合率モル比2：82：10）を溶融押出しし、35μの乗延伸フィルムを得た。その物性は第1図の通りであり、低層ヒートシール性はあるが、引張性が劣り、膜がないために自動包膜適性が劣っている。

## 比較例 2

実施例1と同一の樹脂組成、製法方法で厚さ1000μの乗延伸被覆フィルムを作り、次いで120℃で横方向に5倍延伸し、155℃で縦方向に8倍延伸して、5%の緩和率を与えながら140℃で5秒間熱処理した。

得られた被覆フィルムは、ヒートシール層厚み5μ、全厚み25μの2層延伸被覆フィルムである。

## 特開明63-132051 (5)

り、その物性は第1図に示す通りであって、引裂きの方向性が好んでいる。

特 性	実施例1	比較例1	比較例2
ヘイズ (%)	2.5	2.5	2.5
ヤング率 (kg/mm <sup>2</sup> )	クラ/ロコ	150/380	100/250
引裂きの方向性	ロコ	○	×
ヒートシール強度 (g/cm)	150℃	30	30
	130	850	850
	140	650	650
	150	—	700
	160	—	120
	180	—	620
自動切断性	○	×	×

## 実施例 2

実施例1の方法で得た本発明の放電フィルムをベース層面に厚さ12μの二軸延伸ポリエスチルフィルムをポリウレタン系接着剤を用いてドライラミネートした。また比較例として①単層延伸ポリプロピレンフィルム（厚さ25μ）、②二軸延

伸ポリプロピレンフィルム（厚さ25μ）及び③単一軸延伸ポリプロピレンフィルム（厚さ25μ）と単層延伸ポリプロピレンフィルム（厚さ25μ）とを接着剤（厚さ1μ）でラミネートしたものにそれぞれ二軸延伸ポリプロピレンフィルム（厚さ12μ）をポリウレタン系接着剤（厚さ1μ）を介してドライラミネートしたものを作成し、その特性を比較した。その結果を第2表に示した。なお①、②及び③のラミネートフィルムについて順次、比較例2、比較例4及び比較例5とした。

以下空白

特 性	実施例2	比較例3	比較例4	比較例5
厚 さ (μ)	25	25	25	25
厚 さ (実測値)	中程度	薄 い	やや厚い	薄 い
引裂きの方向性	○	×	×	○
手切れ性	○	×	△	×
ヒートシール強度 (g/cm)	850	700	850	850
(150℃)				

- 1 : ベースフィルム層
- 2 : ヒートシール性フィルム層
- 3 : 接着剤層
- 4 : 延伸フィルムもしくは紙
- 5 : アルミエラム層

特許出願人 東洋紡績株式会社

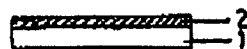
第2表から明らかなように、本発明の放電フィルムは引裂きの方向性、手切れ性及びヒートシール強度がすべて良好であるのに対して、比較例のものは引裂きの方向性又は手切れ性が悪く、包装品とした場合に、不都合な結果を招く。

## 4. 図面の簡単な説明

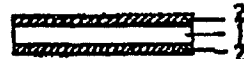
第1図及び第2図は、本発明の放電フィルムの一例を示す断面図であり、第3図及び第4図は、第1図の放電フィルムの片面に他のフィルム等を積層した複合フィルムの一例を示す断面図である。

特開明 63-132051 (6)

第 1 図



第 2 図



第 3 図



第 4 図



1. ベースフィルム層
2. ヒートシール性フィルム層
3. 接着剤層
4. 延伸フィルムもしくは紙
5. アルミニウム箔